

MicroLED为什么短期道阻但是长远可期？

产品名称	MicroLED为什么短期道阻但是长远可期？
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

MicroLED凭借亮度对比度、高清晰度、负色、轻便化、小型化、节能型、设计灵活等特点，已被称作AR/VR显示屏*优计划方案之一，但MicroLED真正商业化之路还很有艰难能通过。具体来说，MicroLED目前遭受“三座大山”：解决处理芯片高效化、很多转移、精彩纷呈化。而解决处理芯片效率问题、很多转移生产制造会使MicroLED显示屏精彩纷呈化导致直接影响。*先，解决处理芯片高效化会随着MicroLED芯片型号的小型而降低，尤其是红色光解决处理芯片。当芯片尺寸小于20 μ m以下时，EQE显著下降，而红色光解决处理芯片效率蓝绿光芯片高效化误差能够达到5倍以上。即便有店家明确指出采用BGRR解决方案来进行柔光灯，但更多LED数量代表了转移次数提高，可能造成成本费用持续增长，因此竞争能力并不太好。次之，很多转移方法与技术尽管多种多样，但据把握，由于AR/VR微显示器芯片尺寸微小，转移难度高，所以现阶段很多转移方式以Wafer Bonding（单晶硅键合线）、Chip Bonding（解决处理芯片键合线）或Laser Transfer（激光发生器镭射激光转移）为主体。据统计，绝大多数生产厂家采用Wafer Bonding、Chip Bonding计划计划方案，就是把单晶硅或解决处理器与CMOS档板结合的生产制造，不过目前只能进行单一色彩，精彩纷呈化生产制造遭受非常大磨练，而激光发生器镭射激光转移技术可以解决这个问题，进行微显示器精彩纷呈化规格技术参数，目前K&S、Coherent等正在积极新产品开发，但此方案并没有进入批量生产阶段，且机械设备非常昂贵，而这也成为MicroLED微显示器商业化的一大阻止。